

次世代パターン用直接描画装置「LeVina」を開発

株式会社SCREENホールディングスはこのほど、「デジタル×グリーン化」へとメガトレンドが変化しつつある先端パッケージングの大きな変革に合わせ、高精細パターン形成に対応する次世代パターン用直接描画装置「LeVina（レビーナ）」を開発。2022年4月から販売を開始します。



LeVina

☆この画像の印刷用データ（解像度300dpi）は、
下記URLよりダウンロードできます。
(www.screen.co.jp/about/nr-photo_2022)

近年、DX（デジタルトランスフォーメーション）およびグリーン化など、社会的課題への要求が高まる中、ICパッケージ基板技術のさらなる高性能化が求められています。高性能化のためには従来よりも微細なパターン形成が必要不可欠であり、ICパッケージ基板業界では、高精細な描画性と高生産性を両立できる直接描画装置へのニーズが高まっています。

このような動向を背景に当社は、ICパッケージ基板向け直接描画装置として、全世界で累計600台以上の導入実績を持つ「Lediaシリーズ」に、独自開発のGLV光学エンジンを搭載した描画ヘッド、および、長年培った光学システムによるレーザー制御技術を融合。世界最高水準の解像度5 μ mを実現できる次世代パターン用直接描画装置「LeVina」を開発しました。毎秒480mm移動する高速ステージの採用や、スキャンアライメント機能の搭載により、ラインアンドスペース5 μ mの解像度で1時間あたり100枚の高速量産を実現しています。

当社は、5G/ポスト5G関連やIoTインフラを中心に拡大が続くパッケージ基板市場へのビジネス展開を加速させるとともに、今後も半導体パッケージ業界のさまざまなニーズに応え、同業界の発展に貢献していきます。

第36回 ネブコン ジャパン

2022年1月19日（水）から21日（金）まで東京・有明の東京ビッグサイトで開催される「第36回 ネブコン ジャパン（第23回 半導体・センサ パッケージング技術展）」に出展します。

URL : <https://www.nepconjapan.jp/ja-jp.html>

● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREENホールディングス コーポレートマーケティング室 Tel: 075-414-7698 levina@screen.co.jp